



Des MOSFET automobiles compacts et robustes à flancs mouillables

Le nouveau boîtier DFN2020B(WF) améliore la fiabilité, la miniaturisation et l'AOI pour les applications automobiles de nouvelle génération

Düsseldorf, Allemagne, le 24 mars 2026 – Toshiba Electronics Europe GmbH (« Toshiba ») annonce le lancement de cinq nouveaux produits automobiles MOSFET, conçus pour allier gain de place et facilité de montage. Ces MOSFET à canal N ([XSM6K361NW](#), [XSM6K519NW](#), [XSM6K376NW](#), et [XSM6K336NW](#)) et à canal P ([XSM6J372NW](#)) sont logés dans le boîtier DFN2020B(WF), doté d'une structure à flancs mouillables.

Le boîtier DFN2020B(WF) représente une avancée significative dans le domaine de l'électronique automobile, offrant de multiples avantages. La structure à flancs mouillables améliore la mouillabilité de la soudure par rapport au boîtier UDFN6B existant de Toshiba. Essentiellement, elle accroît également la visibilité du cordon de soudure, ce qui permet de confirmer la qualité des joints de soudure à l'aide d'un équipement d'inspection optique automatisée (*Automated Optical Inspection*, AOI). De plus, lors des tests de résistance au cisaillement des joints de soudure, le nouveau boîtier présente une résistance environ 23 % supérieure à celle du boîtier SOT-23F existant de Toshiba, ce qui contribue à augmenter la fiabilité.

Avec un boîtier de taille typique de 2,0 mm x 2,0 mm x 0,6 mm, le boîtier DFN2020B(WF) réduit la surface de montage d'environ 43 % et la hauteur d'environ 25 % par rapport au boîtier SOT-23F (2,4 mm x 2,9 mm x 0,8 mm typ.). Cette réduction de taille est cruciale pour la miniaturisation des équipements automobiles modernes.

Malgré sa taille compacte, ce nouveau boîtier offre une capacité de dissipation thermique élevée. Par exemple, le XSM6K361NW affiche une dissipation de puissance maximale de 1,84 W, soit environ 1,5 fois supérieure aux 1,2 W du SSM3K361R existant de Toshiba avec un boîtier SOT-23F. Cette capacité de dissipation thermique élevée permet le développement d'équipements automobiles compacts nécessitant des MOSFET haute

puissance, tels que les convertisseurs DC-DC pour les ECU (Electronic Control Unit) et les interrupteurs de charge pour phares à LED.

Ces nouveaux produits sont conformes à la norme AEC-Q101, la spécification de fiabilité standard de l'industrie automobile. De plus, le processus d'approbation des composants de production (*Production Part Approval Process*, PPAP) de la norme IATF16949, norme internationale pour les systèmes de gestion de la qualité spécifiques à l'industrie automobile, est disponible.

Toshiba s'engage à élargir sa gamme de MOSFET avec le boîtier DFN2020B(WF) et à lancer prochainement des MOSFET 2-en-1 avec le boîtier DFN2020(WF) pour les applications automobiles.

Pour plus d'informations sur les nouveaux MOSFET automobiles en boîtier DFN2020B(WF), veuillez consulter le site Web de Toshiba :

[XSM6K361NW](#)

[XSM6K519NW](#)

[XSM6K376NW](#)

[XSM6K336NW](#)

[XSM6J372NW](#)

###

À propos de Toshiba Electronics Europe

[Toshiba Electronics Europe GmbH](#) (TEE) offre aux consommateurs et aux entreprises d'Europe une grande variété de lecteurs de disques durs (*hard disk drive*, HDD) ainsi que des solutions de semi-conducteurs pour l'automobile, l'industrie, l'IoT, le contrôle de mouvement, les télécommunications, les réseaux, la grande consommation et les produits blancs. Outre les disques durs, le vaste portefeuille de l'entreprise comprend des semi-conducteurs de puissance et d'autres composants discrets allant des diodes aux circuits intégrés logiques et aux semi-conducteurs optiques, ainsi que des microcontrôleurs et des produits standard spécifiques à l'application (*application specific standard products*, ASSP), entre autres. En outre, TEE propose également des cellules et des modules de batterie SCiB™ avec de l'oxyde de lithium et de titane (LTO) pour les applications les plus exigeantes.

TEE a son siège à Düsseldorf, en Allemagne, et des succursales en France, en Italie, en Espagne, en Suède et au Royaume-Uni qui fournissent des services de marketing, de vente et de logistique.

Visitez les sites Web de Toshiba à www.toshiba.semicon-storage.com et www.scib.jp/en pour plus d'informations sur la société et ses produits.

Contact pour publication :

Toshiba Electronics Europe GmbH, Hansaallee 181, D-40549 Düsseldorf, Allemagne

Tél : +49 (0) 211 5296 0

Web : www.toshiba.semicon-storage.com/eu/company/news.html

Contact presse :

Michelle Shrimpton, Toshiba Electronics Europe

Tél : +44 (0)7464 493526

E-mail : MShrimpton@teu.toshiba.de

Publié par:

Birgit Schöniger, Pretzl

Tel: +49 (0) 172 617 8431

Web: www.pretzl.com

E-mail : birgit.schoeniger@pretzl.com

Mars 2026

Ref. 7638F